

株式会社 弘輝

〒120-0026 東京都足立区千住旭町 32-1

TEL: 03-5244-1511 FAX: 03-5244-1527

www.ko-ki.co.jp



2018年12月

インターネットコン ジャパン 出展のお知らせ

2019年1月16日(水) - 18日(金) 東京ビッグサイト 東ホール E4-17

株式会社弘輝(本社:東京都、社長:伊藤学)は、2019年1月16日～18日に東京ビッグサイトにて開催される、第48回 インターネコンジャパンに出展いたしますので、ここにお知らせ申し上げます。

今回の出展においては、「車載のいまとこれからを支える最新のはんだ付け材料」をテーマとしたSMT向けはんだ付け材料、及びパワーエレクトロニクス向けはんだ付け材料をご紹介します。細分化する実装要求に対応した、弘輝の最新はんだ付け材料ラインナップを、是非会場でご覧ください。

【SMT向けはんだ材料 出展製品】

S3X58-G803: 超低ボイドソルダーペースト。新規採用の活性剤技術で、リフロープロファイルや部品種を問わず、ボイドの発生を大幅に抑制します。これまでのボイド低減技術に加え、はんだが熔融する前に金属表面の酸化膜を除去することで、はんだ接合部中に残留するボイドを更に低減することに成功しました。

SB6NX58-HF350: 冷熱サイクルへの耐久性が高い高耐久合金を使用した、完全ハロゲンフリーソルダーペースト。製品性能と採用実績に裏打ちされた安定の高耐久合金と、弘輝が蓄積してきたハロゲンフリーフラックス技術を融合させ、性能バランスに優れた完全ハロゲンフリーソルダーペーストが完成しました。

S3X58-HF900N: 厳しい条件においても高い絶縁信頼性を確保したソルダーペースト。従来品ではマイグレーション発生の恐れがある狭ピッチにおいても、マイグレーションが発生せず、従来品よりも1-2乗程度高い絶縁性を確保します。

S3X58-HF912: フラックス飛散レス ソルダーペースト。センサーやコネクタ端子、レンズといったフラックスの飛散を嫌う部品のはんだ付け材料として最適です。濡れ性やボイド性などの実装品質と、低フラックス飛散性の両立を実現しました。

JU-120EB: CSP、BGAなどのパッケージ部品やコネクタ部品の接合力を向上させる、補強用熱硬化型接着剤。SMT用リフロー炉で容易に効果が可能で、加工後に補修ができるリペア性にも優れています。

【パワーエレクトロニクス向けはんだ材料 出展製品】

E12シリーズ: IGBTやパワーMOSFET等のパワーデバイス接合用ソルダーペースト。はんだ箔接合を代替する超低ボイドを実現、総合的なコストダウンが可能です。

【弘輝のはんだ付け関連サポートのご紹介】

弘輝では、弊社製品をご利用いただいているお客様向けに、実装工程のベストパフォーマンス実現をお手伝いする「最適化サポート」と、はんだ接合不良の原因を解明する「不良解析サービス」を実施しています。展示会では、サポート・サービスの概要をご紹介します。

【ご来場特典: 事例集進呈】

弘輝ブースにご来場の上、お名刺を頂戴したお客様に、はんだ接合部ボイド事例集を進呈いたします。是非、弘輝ブースへご来場ください。

本件へのお問い合わせ先

株式会社弘輝 営業部 TEL: 03-5244-1511(代表)

KOKI COMPANY LIMITED

32-1. Senju Asahi-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-0026, Japan Tel: +81 3 5244-1521 Fax: +81 3 5244-1525 www.ko-ki.co.jp